

超音波リボンボンダ

RB0300LS
Ultrasonic ribbon bonder

パワーモジュール・二次電池の回路形成

- パワーモジュール DBC 電極間接合
- パワーモジュールフィン形成
- 脆弱な材料への接合
- 二次電池端子間接合



アプリケーション Application

IGBT モジュール

二次電池

DBC 間接合

端子間接合

フィン形成

仕様 Specification	
Bonding force	最大荷重 300N
Head height control	繰返し位置決め精度 $\pm 10\mu\text{m}$
Head availability	超音波ヘッド
Ultrasonic head	周波数：40kHz（30kHz、50kHz にもワンタッチ交換可能）
Ultrasonic output	600W（30kHz：1000W、50kHz：150W）
Head control	位置、荷重、超音波のデジタル制御
Bonding monitor	プロファイル参照ソフト標準搭載
Recipe	接合条件：デジタル設定
Feeder	マルチフィーダー機能
Utility	空圧源 0.5MPa ドライエアー
	電 源 三相 200V 25A
Unit size	W1200 x D1200 x H1900mm
Unit weight	500kg

● パワーモジュール DBC 電極間接合

リボンの接合とカットを行って端子間の接合を行います。

● パワーモジュールフィン形成

リボンボンディングによってプログラマブルに放熱フィンを形成します。

● 脆弱な材料への接合

Al バインダを接合後に Cu リボン接合を行うことで、チップ表面などの脆弱な材料上への回路形成も可能となります。（ABB プロセス）

Al バインダ仮接合

Cu リボン接合

Al バインダ

Cu リボン

● 二次電池端子間接合

端子間を接合して二次電池のセルを結合します。